

**SEMICON<sup>®</sup>**  
**RUSSIA**

7 JUNE 2016 SYMPOSIUM  
8-9 JUNE 2016 EXPO  
MOSCOW, RUSSIA



---

## Прием заявок на выступления

---

# Конференция по Пластиковой Электронике 2016

8-9 июня 2016 / Москва, Россия

---

**SEMI Россия приглашает профессиональных экспертов подать заявку на участие в специальной сессии с докладом, которая будет проходить в рамках международного форума SEMICON Russia 2016 с 8 по 9 июня в Москве в ЭкспоЦентре на Красной Пресне. Пожалуйста, укажите, если Ваша заявка соответствует одной из следующих тематик «Технологии и Материалы», «Производство» или «Бизнес-кейсы».**

Пластиковая электроника и сопутствующие технологии, включающие гибкую, печатную, органическую и электронику больших поверхностей (OLAE), представляют новый способ интеграции интеллектуальных систем, которые могут быть задействованы для использования в широком диапазоне подложек: от низкотемпературной пластиковой фольги до изогнутого стекла, текстиля и даже фармацевтической и пищевой упаковки. Сочетание устройств на традиционных полупроводниковых интегральных схемах (ИС) с новейшими технологиями интеллектуальных датчиков и гибких многофункциональных систем относится к основным мегатрендам, применимым в интернете вещей, носимой электронике, автоматизированных системах, интеллектуальных зданиях и системах взаимодействия с окружающей средой и так далее вплоть до пищевой и упаковочной промышленности.

Например, создание сверхтонких, незаметных и растягиваемых электронных устройств делает возможным появление новых и лучших решений для персонализированной медицины со значительным снижением стоимости и повышением эффективности всего сектора здравоохранения. Появляющиеся новые материалы включают высокоэластичные, биоразлагаемые материалы, усиленные активные волокна, 2D наноматериалы и нанокompозиты.

Технологии производства необходимы для того, чтобы улучшить пропускную способность и производительность пластиковых электронных устройств и схем. Функциональность интеллектуальных повседневных объектов подразумевает повсеместное применение датчиков с прогнозируемым объемом свыше 100 млрд. единиц к 2020 году. Гибридные технологии и возможность упаковки бескорпусных кремниевых микроконтроллеров и других микросхем общего применения, встраиваемые в гибкую и растягивающуюся электронику, позволяют конечным продуктам быть не только тонкими и легкими, но также гибкими и надежными. Новая волна инноваций, включая многофункциональную электронику широкого спектра, в настоящее время активно набирает обороты в различных отраслях промышленности, создавая новые возможности с добавленной стоимостью в существующих продуктах или в совершенно новых продуктовых концепциях.

**Заявки должны включать перечисленные аспекты:**

**ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ.** Включая достижения в разработке новых продуктов на основе органических и неорганических материалов, химических, физических и биосенсоров, электронных и фотонных

устройств, высокоскоростных логических и аналоговых решений обработки данных и решений для аккумуляции и хранения энергии.

**ПРОИЗВОДСТВО.** Интеграция электроники больших поверхностей и гибкой электроники требует новых методов производства, высокой пропускной способности, высокой производственной точности и инновационных технологий корпусирования. Новое поколение методов производства и метрологии аддитивных материалов, низкотемпературной электроники и электроники больших поверхностей совершенствуются и постепенно двигаются от лаборатории к фабричному производству. Сегодняшний масштаб производственных мощностей, доступный за рубежом позволяет новой отрасли быстро создавать прототипы и масштабировать концепции новых продуктов в течение нескольких недель после разработки первоначального дизайна, в сравнении с несколькими месяцами, обычно необходимыми для традиционного производства полупроводников. Освоение методов гибридной интеграционной сборки дает возможность легкой настройки и персонализации конечного продукта за счет интеграции программируемых микроконтроллеров и электроники общего применения в широком разнообразии гибких и больших подложек.

**БИЗНЕС КЕЙСЫ.** Большое количество возможностей гибкой электроники и электроники больших поверхностей заключается в интеграции с уже апробированными КМОП-технологиями, а также применении OLAЕ в новых приложениях и продуктах с более высокой функциональностью, новыми конструктивными параметрами и низкой стоимостью. Гибридная интеграция является важнейшей передовой технологией, позволяющей достичь требуемого уровня производительности и обеспечения коммерциализации проектов. Пластиковая электроника делает возможным быстрый рост инноваций в промышленности, расширяя спектр повседневных объектов и делая их умнее и еще более интерактивными для лучшей жизни.

#### **Формат Конференции:**

6-8 презентаций и дискуссия (3-4 часа).

#### **Инструкция для подачи заявки для доклада**

Основные положения:

- Пожалуйста, направьте краткое описание, Вашу биографию и фото [по электронной почте](#) до **3 апреля 2016**.
- Язык конференции русский/английский. Краткое описание, биографии и доклады должны быть представлены на двух языках.
- Краткое описание должно содержать 400-500 слов и состоять из вступления, описания проблемы/задачи и предлагаемого решения.
- Корректировки и замечания к краткому описанию принимаются строго до 29 мая 2016.

#### **Контактная информация:**

Пожалуйста, посетите наш сайт [www.semiconrussia.org](http://www.semiconrussia.org) за подробной информацией или воспользуйтесь электронной почтой: [esuvorov@semi.org](mailto:esuvorov@semi.org). Контактный телефон: +7 926 910 53 14

Региональный директор SEMI в России и СНГ

Суворов Евгений Александрович

**SEMI Россия**

1125252 Россия, г. Москва

ул. Авиаконструктора Микояна, 12, блок А